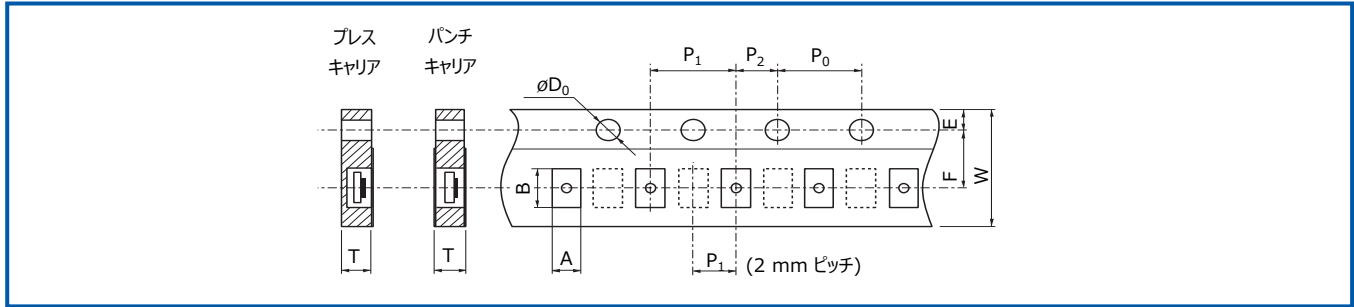


包装方法 (テーピング)

●標準数量

品番	サイズ	タイプ	テーピングの種類	ピッチ(P ₁)	数量
EZAEG1N	0603	単品	プレスキャリアテーピング	2 mm	15,000 pcs / リール
EZAEG2A,2N	1005				10,000 pcs / リール
EZAEG3A	1608		パンチキャリアテーピング	4 mm	5,000 pcs / リール
EZAEG3W	1608				4,000 pcs / リール
EZAEGCA	2012	アレイ			5,000 pcs / リール

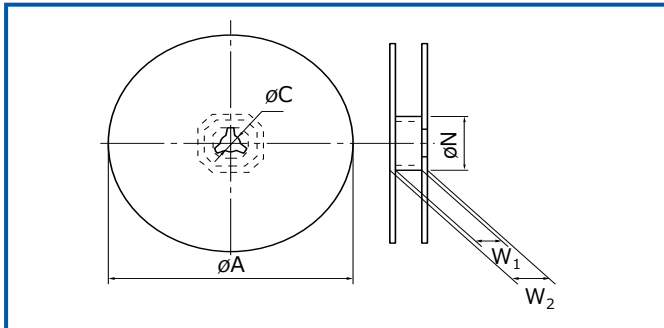
●キャリアテーピング



(mm)

品番	サイズ	A	B	W	F	E	P ₁	P ₂	P ₀	φD ₀	T
EZAEG1N	0603	0.38±0.05	0.68±0.05	8.00±0.20	3.50±0.05	1.75±0.10	2.00±0.10	2.00±0.05	4.00±0.10	1.5 ^{+0.1} ₀	0.42±0.05
EZAEG2A,2N	1005	0.70±0.05	1.20±0.05				0.60±0.05				
EZAEG3A	1608	1.10±0.10	1.90±0.10				0.70±0.05				
EZAEG3W	1608	0.91±0.10	1.82±0.10				1.08±0.10				
EZAEGCA	2012	1.55±0.15	2.30±0.20				0.85±0.05				

●テーピング用リール



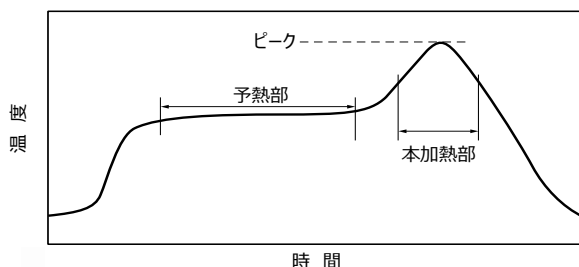
寸法 (mm)		
φA	φN	φC
180.0 ⁰ _{-1.5}	60.0 ^{+1.0} ₀	13.0±0.2
寸法 (mm)		
W ₁	W ₂	
9.0 ^{+1.0} ₀	11.4±1.0	

推奨はんだ付け条件

以下に、本製品の推奨はんだ付け条件に関する推奨条件及び注意事項を示します。

●リフローはんだ付け推奨条件

- ・リフローは 2 回まででご使用ください。
- ・保証温度を超える場合は、必ずご相談ください。
- ・基板及びはんだの種類毎に、製品端子部の温度及びはんだ付け性を予めご確認ください。



共晶はんだの場合 (Sn/Pb 系など)

	温度条件	時間
予熱部	140 °C ~ 160 °C	60 秒 ~ 120 秒
本加熱部	200 °C 以上	30 秒 ~ 40 秒
ピーク	235 ± 5 °C	10 秒以内

鉛フリーはんだの場合 (Sn/Ag/Cu 系など)

	温度条件	時間
予熱部	150 °C ~ 180 °C	60 秒 ~ 120 秒
本加熱部	230 °C 以上	30 秒 ~ 40 秒
ピーク	max. 260 °C	10 秒以内